



## RE900

- Fibre de verre FR4 époxyde 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour 14 chips CMS TSOP I et 7 chips CMS TSOP II différents
- Pitch 0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil); 0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Points destinés à la rupture pour séparer des modules de la platine
- Les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement de l'application de pâte à braser seront mis à la disposition gratuitement
- Dimensions: 72,60 x 76,20 mm

| Module-No. | Type    | Pitch    | Pin                | Dimensions (mm) |
|------------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| RE900-01   | TSOP I  | 0,400 mm | 28, 40, 48, 60     | 12,00 x 18,00   |
| RE900-02   | TSOP I  | 0,500 mm | 28, 32, 40, 48     | 12,00 x 20,00   |
| RE900-03   | TSOP I  | 0,500 mm | 20, 24             | 6,00 x 16,00    |
| RE900-04   | TSOP I  | 0,650 mm | 16, 24, 28, 36     | 12,00 x 14,00   |
| RE900-05   | TSOP II | 0,800 mm | 40, 44             | 11,50 x 18,80   |
| RE900-06   | TSOP II | 1,270 mm | 20, 24, 26, 28, 32 | 11,50 x 21,30   |